



平成27年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年7月29日

上場取引所 東

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

コード番号 8035 URL <http://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役会長兼社長

(氏名) 東 哲郎

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 執行役員

(氏名) 原田 芳輝

TEL 03-5561-7000

四半期報告書提出予定日 平成26年8月8日

配当支払開始予定日

平成26年8月20日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年3月期第1四半期の連結業績(平成26年4月1日～平成26年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 四半期純利益 | |
|-------------|---------|-------|--------|---|--------|---|--------|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 27年3月期第1四半期 | 151,325 | 46.3 | 17,069 | — | 16,913 | — | 11,835 | — |
| 26年3月期第1四半期 | 103,452 | △22.9 | △9,646 | — | △9,898 | — | △2,976 | — |

(注) 包括利益 27年3月期第1四半期 12,241百万円 (485.0%) 26年3月期第1四半期 2,092百万円 (△21.0%)

| | 1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
|-------------|-------------|--------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 27年3月期第1四半期 | 66.04 | 65.88 |
| 26年3月期第1四半期 | △16.61 | — |

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 |
|-------------|---------|---------|--------|
| | 百万円 | 百万円 | % |
| 27年3月期第1四半期 | 768,783 | 586,605 | 76.1 |
| 26年3月期 | 828,591 | 590,613 | 69.8 |

(参考) 自己資本 27年3月期第1四半期 584,731百万円 26年3月期 578,091百万円

2. 配当の状況

| | 年間配当金 | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 26年3月期 | — | 25.00 | — | 25.00 | 50.00 |
| 27年3月期 | 10.00 | — | — | — | — |

*当社はアプライド マテリアルズとの経営統合を発表しておりますが、日本、米国その他の国における適用ある競争法に基づく関係当局の承認等を条件としておりますため、経営統合の効力発生日が未定であります。このような状況に鑑み、平成27年3月期第2四半期以降の配当予想は公表しておりません。

3. 平成27年 3月期の連結業績予想(平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり当期純利益 |
|-----------|---------|------|--------|---|--------|---|--------|-------|------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| 第2四半期(累計) | 290,000 | 13.9 | 24,500 | — | 24,500 | — | 15,500 | 525.8 | 86.49 |
| 通期 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

*平成27年3月期の連結業績予想につきましては、アプライドマテリアルズとの経営統合効力発生日が未定であることから、暫定的に第2四半期連結累計期間までの業績予想を開示いたします。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、【添付資料】6ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

詳細は、【添付資料】6ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

| | | | |
|----------|---------------|----------|---------------|
| 27年3月期1Q | 180,610,911 株 | 26年3月期 | 180,610,911 株 |
| 27年3月期1Q | 1,408,363 株 | 26年3月期 | 1,408,950 株 |
| 27年3月期1Q | 179,203,670 株 | 26年3月期1Q | 179,187,348 株 |

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】5ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は、平成26年7月29日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料につきましては、開催と同時に当社ホームページに掲載する予定です。

【添付資料】

[目次]

| | |
|------------------------------|----|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報 | 2 |
| (1) 経営成績に関する説明 | 2 |
| (2) 財政状態に関する説明 | 4 |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 | 5 |
| 2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 | 6 |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 | 6 |
| (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 | 6 |
| (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | 6 |
| 3. 四半期連結財務諸表 | 7 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | 7 |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 | 8 |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 | 10 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 10 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 10 |
| (セグメント情報等) | 10 |

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間につきましては、中国、インドで成長テンポが鈍化しているものの、世界経済全体としては緩やかに回復しています。日本においても、緩やかな景気回復基調が続いています。

当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業におきましては、中国において高速通信インフラの整備が急速に進むなど、新興国を中心にスマートフォン市場の拡大が続き、モバイル端末の需要は好調に推移しております。

このような状況のもと、当社グループの当第1四半期連結累計期間の連結業績は、売上高1,513億2千5百万円(前年同期比46.3%増)、営業利益170億6千9百万円(前年同期は96億4千6百万円の営業損失)、経常利益169億1千3百万円(前年同期は98億9千8百万円の経常損失)、また、四半期純利益は118億3千5百万円(前年同期は29億7千6百万円の四半期純損失)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

なお、当社は本年4月及び5月に東京エレクトロン デバイス(株)の一部を売却いたしました。これにより、当社が当社の連結子会社から持分法適用関連会社へ異動し、当第1四半期連結会計期間から、当社及びその子会社が担っていた「電子部品・情報通信機器」を報告セグメントから除外しました。上述の連結売上高の前年同期比増減率(46.3%増)につきましては、当社を連結の範囲から除外した影響が反映されたものであります。

① 半導体製造装置

好調なスマートフォンやタブレットPCの販売を受け、DRAMやNANDフラッシュメモリー等の電子部品の需要は堅調に推移しており、半導体メーカーの設備投資は増加基調となりました。このような状況のもと、当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は1,361億2千6百万円(前年同期比81.6%増)となりました。

② FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置

モバイル端末向けを中心とした中小型液晶パネル需要は順調に推移しており、FPD製造装置市場は中国における大型液晶パネル向けも含め、引き続き堅調でした。このような状況のもと、当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、139億2千9百万円(前年同期比183.9%増)となりました。

③ PV(太陽光パネル)製造装置

太陽光パネル製造装置の新規販売活動の撤退を決定しておりますが、受注済み装置に対する工事進行基準による売上高等の計上により、当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、11億2百万円(前年同期比46.6%減)となりました。

④ その他

当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、1億6千7百万円(前年同期比50.4%増)となりました。

(ご参考)

【連結業績】

(単位：百万円)

| | 前期通期 | | | | | 当期第1Q |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 前期第1Q | 前期第2Q | 前期第3Q | 前期第4Q | | |
| 売上高 | 612,170 | 103,452 | 151,048 | 138,400 | 219,269 | 151,325 |
| 半導体製造装置 | 478,841 | 74,944 | 119,828 | 102,284 | 181,784 | 136,126 |
| 日本 | 76,424 | 11,648 | 21,585 | 21,589 | 21,601 | 13,421 |
| 米国 | 104,363 | 15,101 | 29,715 | 24,474 | 35,071 | 33,790 |
| 欧州 | 29,636 | 5,666 | 7,909 | 3,815 | 12,244 | 12,530 |
| 韓国 | 73,403 | 11,184 | 17,679 | 14,660 | 29,877 | 22,451 |
| 台湾 | 130,252 | 24,509 | 31,550 | 21,504 | 52,688 | 38,456 |
| 中国 | 48,897 | 4,711 | 4,924 | 12,764 | 26,496 | 13,911 |
| 東南アジア他 | 15,865 | 2,123 | 6,463 | 3,474 | 3,803 | 1,565 |
| F P D製造装置 | 28,317 | 4,906 | 4,486 | 8,813 | 10,110 | 13,929 |
| P V製造装置 | 3,805 | 2,062 | 1,225 | 1,196 | △679 | 1,102 |
| 電子部品・情報通信機器 | 100,726 | 21,426 | 25,359 | 26,029 | 27,910 | — |
| その他 | 479 | 111 | 146 | 76 | 144 | 167 |
| 営業利益(△損失) | 32,204 | △9,646 | 7,824 | 9,067 | 24,959 | 17,069 |
| 経常利益(△損失) | 35,487 | △9,898 | 10,487 | 8,502 | 26,395 | 16,913 |
| 四半期(当期)純利益(△損失) | △19,408 | △2,976 | 5,452 | △38,098 | 16,212 | 11,835 |

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

【生産及び受注の実績】

1. 生産実績

(単位：百万円)

| | 前期通期 | | | | | 当期第1Q |
|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 前期第1Q | 前期第2Q | 前期第3Q | 前期第4Q | | |
| 半導体製造装置 | 470,086 | 79,358 | 105,784 | 145,944 | 138,999 | 124,318 |
| F P D製造装置 | 36,047 | 6,037 | 4,777 | 9,508 | 15,724 | 7,419 |
| P V製造装置 | 3,876 | 2,146 | 1,212 | 1,226 | △709 | 1,081 |
| 合計 | 510,010 | 87,542 | 111,774 | 156,679 | 154,014 | 132,818 |

(注) 1. 金額は販売価格によっております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 受注実績(受注高)

(単位：百万円)

| | 前期通期 | | | | | 当期第1Q |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 前期第1Q | 前期第2Q | 前期第3Q | 前期第4Q | | |
| 半導体製造装置 | 546,932 | 97,708 | 151,322 | 143,495 | 154,405 | 137,297 |
| F P D製造装置 | 41,336 | 14,491 | 6,351 | 3,885 | 16,607 | 14,280 |
| P V製造装置 | 4,303 | 1,185 | 1,101 | 1,447 | 569 | 541 |
| 電子部品・情報通信機器 | 103,141 | 23,872 | 24,735 | 26,525 | 28,008 | — |
| その他 | 479 | 111 | 146 | 76 | 144 | 167 |
| 合計 | 696,194 | 137,369 | 183,657 | 175,431 | 199,735 | 152,286 |

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績 (受注残高)

(単位：百万円)

| | 前期第1Q | 前期第2Q | 前期第3Q | 前期第4Q | 当期第1Q |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 半導体製造装置 | 164,587 | 196,081 | 237,292 | 209,914 | 211,085 |
| F P D製造装置 | 25,584 | 27,449 | 22,522 | 29,019 | 29,371 |
| P V製造装置 | 7,618 | 7,494 | 7,744 | 8,994 | 8,433 |
| 電子部品・情報通信機器 | 17,231 | 16,606 | 17,102 | 17,200 | — |
| その他 | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 215,022 | 247,632 | 284,663 | 265,129 | 248,889 |

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 財政状態に関する説明

① 財政状態

当第1四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ598億3千1百万円減少し、5,616億6千万円となりました。主な内容は受取手形及び売掛金の減少316億1千4百万円、たな卸資産の減少271億4千4百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から16億8千万円減少し、1,106億6千3百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から26億8千9百万円減少し、268億6千6百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から43億9千3百万円増加し、695億9千3百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から598億8百万円減少し、7,687億8千3百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ471億5千8百万円減少し、1,233億5千1百万円となりました。主として、支払手形及び買掛金の減少122億4千6百万円、東京エレクトロン デバイス(株)の連結除外による短期借入金の減少115億3千1百万円、前受金の減少107億9千9百万円、未払法人税等の減少85億6千2百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ86億4千2百万円減少し、588億2千6百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ40億7百万円減少し、5,866億5百万円となりました。主として、四半期純利益118億3千5百万円を計上したことによる増加、東京エレクトロン デバイス(株)の連結除外等による少数株主持分の減少106億7千1百万円、前期の期末配当44億8千万円の実施による減少によるものであります。この結果、自己資本比率は76.1%となりました。

② キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ341億6千6百万円増加し、1,389億6千3百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資1,410億4千7百万円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ118億6千4百万円増加し、2,800億1千1百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期の13億7千万の支出に対し、164億4千7百万円の収入となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益150億2千2百万円、未収消費税等の減少100億7千2百万円、売上債権の減少82億3千1百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額125億6千万円、前受金の減少68億6千6百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出になったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として定期預金及び短期投資の減少による収入223億円、有形固定資産の取得による支出30億5千9百万円により、前年同期の132億7百万円の収入に対し210億6千万円の収入となりました。

財務活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払44億8千万円により、前年同期の14億4千2百万円に対し46億1千4百万円となりました。

【連結キャッシュ・フロー(要約)】

(単位：百万円)

| | 前第1四半期 連結累計期間 | 当第1四半期 連結累計期間 |
|--|------------------|------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,370 | 16,447 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △9,845 | 15,022 |
| 減価償却費 | 6,307 | 4,717 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,111 | 8,231 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,751 | 4,992 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 715 | △4,096 |
| その他 | 12,092 | △12,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,207 | 21,060 |
| 定期預金及び短期投資の増減額(△は増加) | 17,651 | 22,300 |
| その他(固定資産の取得等) | △4,443 | △1,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,442 | △4,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,134 | 1,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,260 | 34,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,313 | 104,797 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,206 | — |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,367 | 138,963 |
| 現金及び現金同等物並びに満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資の四半期末残高 | 229,552 | 280,011 |

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

半導体関連市場につきましては、堅調なモバイル機器需要により、半導体メーカーの設備投資は活発化しております。このような状況のもと、当第2四半期連結累計期間において半導体製造装置事業の売上高及び利益が前回予想よりも増加する見込みとなったことにより、第2四半期連結累計期間の業績予想を修正いたします。なお、通期の業績予想につきましては、経営統合の効力発生時期の関係で開示しておりませんが、当社グループベースの下半期といたしましては、前回予想と変わらず、売上高3,070億円、営業利益480億円を想定しております。

平成27年3月期 第2四半期連結累計期間の連結業績予想

| | 第2四半期連結累計期間 |
|-----------|------------------------|
| 売上高 | 2,900億円 (前年同期比 13.9%増) |
| 半導体製造装置 | 2,700億円 (前年同期比 38.6%増) |
| F P D製造装置 | 180億円 (前年同期比 91.6%増) |
| P V製造装置 | 20億円 (前年同期比 39.2%減) |
| その他 | 0億円 |
| 営業利益 | 245億円 |
| 経常利益 | 245億円 |
| 四半期純利益 | 155億円 (前年同期比525.8%増) |

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第1四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

なお、当該会計基準等の適用が連結財務諸表に与える影響は、軽微であります。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年6月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 56,345 | 47,521 |
| 受取手形及び売掛金 | 129,032 | 97,417 |
| 有価証券 | 211,800 | 232,489 |
| 商品及び製品 | 114,289 | 86,978 |
| 仕掛品 | 38,074 | 37,326 |
| 原材料及び貯蔵品 | 15,912 | 16,827 |
| その他 | 57,538 | 44,517 |
| 貸倒引当金 | △1,502 | △1,418 |
| 流動資産合計 | 621,492 | 561,660 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 112,344 | 110,663 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 9,400 | 8,675 |
| その他 | 20,155 | 18,191 |
| 無形固定資産合計 | 29,556 | 26,866 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 67,065 | 71,459 |
| 貸倒引当金 | △1,866 | △1,866 |
| 投資その他の資産合計 | 65,199 | 69,593 |
| 固定資産合計 | 207,099 | 207,123 |
| 資産合計 | 828,591 | 768,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 53,667 | 41,421 |
| 製品保証引当金 | 10,072 | 10,333 |
| その他の引当金 | 8,642 | 3,996 |
| その他 | 98,127 | 67,600 |
| 流動負債合計 | 170,509 | 123,351 |
| 固定負債 | | |
| その他の引当金 | 582 | 374 |
| 退職給付に係る負債 | 53,448 | 48,610 |
| その他 | 13,436 | 9,840 |
| 固定負債合計 | 67,468 | 58,826 |
| 負債合計 | 237,978 | 182,177 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 54,961 | 54,961 |
| 資本剰余金 | 78,023 | 78,023 |
| 利益剰余金 | 436,174 | 442,422 |
| 自己株式 | △9,478 | △9,473 |
| 株主資本合計 | 559,679 | 565,933 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,592 | 5,861 |
| 繰延ヘッジ損益 | 60 | △46 |
| 為替換算調整勘定 | 5,777 | 6,509 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 6,981 | 6,473 |
| その他の包括利益累計額合計 | 18,411 | 18,797 |
| 新株予約権 | 1,643 | 1,667 |
| 少数株主持分 | 10,878 | 206 |
| 純資産合計 | 590,613 | 586,605 |
| 負債純資産合計 | 828,591 | 768,783 |

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) |
|-------------------------------------|---|---|
| 売上高 | 103,452 | 151,325 |
| 売上原価 | 73,535 | 95,942 |
| 売上総利益 | 29,916 | 55,383 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 研究開発費 | 17,993 | 16,754 |
| その他 | 21,570 | 21,558 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 39,563 | 38,313 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △9,646 | 17,069 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 326 | 275 |
| 受取配当金 | 237 | 305 |
| その他 | 373 | 282 |
| 営業外収益合計 | 937 | 863 |
| 営業外費用 | | |
| 為替差損 | 1,096 | 852 |
| その他 | 91 | 166 |
| 営業外費用合計 | 1,188 | 1,019 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △9,898 | 16,913 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 74 | 55 |
| 投資有価証券売却益 | - | 54 |
| 特別利益合計 | 74 | 110 |
| 特別損失 | | |
| 子会社株式売却損 | - | 1,609 |
| その他 | 21 | 392 |
| 特別損失合計 | 21 | 2,001 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △9,845 | 15,022 |
| 法人税等 | △6,876 | 3,169 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△) | △2,969 | 11,853 |
| 少数株主利益 | 6 | 18 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △2,976 | 11,835 |

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) |
|--|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失 (△) | △2,969 | 11,853 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 288 | 269 |
| 繰延ヘッジ損益 | 53 | △117 |
| 為替換算調整勘定 | 4,719 | 739 |
| 退職給付に係る調整額 | - | △498 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | - | △5 |
| その他の包括利益合計 | 5,061 | 387 |
| 四半期包括利益 | 2,092 | 12,241 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,016 | 12,221 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 75 | 19 |

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

① 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」、「FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置」及び「PV(太陽光パネル)製造装置」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、プラズマエッチング/アッシング装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「PV製造装置」は、薄膜シリコン太陽光パネル用製造装置の開発・製造・販売・保守サービス等を行っていましたが、平成26年3月末をもって新規装置の製造開発、販売活動を停止し、納入済み装置に対するサポートのみを行っております。

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)

(単位：百万円)

| | 報告セグメント | | | その他 (注) 1 | 合計 | 調整額 (注) 2 | 四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3 |
|--------------------|-------------|-------------|------------|--------------|---------|--------------|----------------------------|
| | 半導体 製造装置 | FPD 製造装置 | PV 製造装置 | | | | |
| 売上高 | 136,126 | 13,929 | 1,102 | 2,894 | 154,052 | △2,727 | 151,325 |
| セグメント利益 又は損失(△) | 32,034 | △451 | △3,042 | 438 | 28,978 | △13,955 | 15,022 |

- (注) 1. 「その他」は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの物流、施設管理及び保険業務等であります。
2. セグメント利益又は損失の調整額△13,955百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用等が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△3,869百万円等であります。
3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

③ 報告セグメントの変更等に関する事項

当社の連結子会社でありました東京エレクトロン デバイス株式会社が持分法適用関連会社へ異動したことに伴い、当第1四半期連結会計期間より、同社及びその子会社が担っていた「電子部品・情報通信機器」を報告セグメントから除外し、同社に係る持分法投資損益はセグメント利益又は損失の調整額に含めております。

④ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。